



千住金属工業

営業一部 統轄部長

平山 充芳 氏



〈プロフィル〉

1990年4月入社、はんだ付け材料の営業担当として関東地区の大手顧客を担当したのち、2003年に名古屋営業所へ異動となり、車載関係の顧客を中心を開拓。12年には中国（上海）のグループ会社に赴任、副総経理として日系企業はもとより多くの現地顧客を開拓する。14年帰任と同時にはんだ付け材料部門の部長に就任。17年には統轄部長に就任し、国内外問わず営業活動の最前線を統轄する立場としてその手腕を発揮。さらには長年の営業経験を生かし部下の育成にも注力している。

千住金属工業は、産業界のカーボンニュートラル（CN）に対する関心が高まる中で、はんだ事業の観点からCNに貢献すべく、低温はんだ（低融点はんだ）を使用したフローソルダーリングの製造プロセスを開発し、実装業界に向け広く提案を始めている。

◇

— 実装業界でもCO₂削減に対する関心が高まっています。

平山部長 はんだの融点が低いことは、はんだ槽の省電力化のみならず装置の消耗低減など、ソルダーリングのさまざまな

プロセスにおいて好影響を及ぼし、その結果がCNにつながる。当社は低温（低融点）はんだ付け材料から、低温はんだに対応したフローソルダーリング（ウェーブ方式）専用はんだ付け装置までをトータルで提供することで、はんだ業界におけるCNのリーディングカンパニーを目指す。

— 低温はんだに対応したフローソルダーリングの技術や製品について教えてください。

平山部長 実用化するためには、はんだ槽はSn-Bi系低融

はんだ事業の観点でCNに貢献

未来を拓く技術者・研究者・担当者に聞く

点はんだで発生しやすいドロスを低減し、基板に付着するドロス量を少なくする新たな噴流ノズルや、ドロスをフロー装置内で再利用する技術などさまざまな開発を行ってきた。

Sn-Bi低温はんだとして棒はんだ、やに入りはんだ、さらにSn-Bi系の流动性を改善し、Sn-Cu並みのぬれ性を確保したフラックスもそろえ、加えて修正・後付け用のやに入りはんだまでそろえたことで、同一はんだ組成による高品質のはんだ付けができる。新しいプロセスにより量産が可能になり白物家電やパソコンなどに採用が始まった。今後は紙フェノール基板やPET基板などへの展開も視野に、さまざまな製品の実装に向けて提案を広げたい。

— 1月25日から3日間、東京ビッグサイトで開催された「第15回国際カーエレクトロニクス技術展」に出展されました。

平山部長 当社が取り組むCNに貢献する低温フローソルダーリングの新技術、新製品を一挙に展示した。

会場で、はんだ槽の新たなブランディングとして「MILATERA（ミラテラ）」を発表した。これまでSn-Ag-Cuでは「エコソルダー」としてブランディングの浸透を図ってきた。CNを目指す中で、未来を見つめながら次世代のソルダーリングカンパニーとして成長する目的からMILATERAによる新たなブランディング戦略を展開し、実

MILATERA
Low Temperature Soldering for Earth

「MILATERA」ロゴ



低温プロセス向けはんだ槽
実装業界に貢献したいという思い
を込めていた。

— 展示ブースでは特徴ある
独自の製品を紹介されました。

平山部長 新たに開発した
「環境調和型リフロー炉」SNR-GTⅡを出展した。リフロー炉内霧囲気の循環効率を向上させ、断熱構造の強化で消費電力量をSNR-GT比約10%削減した。窒素使用量も装置の入り口と出口部分にラビリングゾーンを設け、窒素カーテン機構を加えて炉内の窒素霧囲気流出を抑制し、さらに循環効率を向上させSNR-GT比で半減した。

車載用電子回路基板の要求に応えるはんだ材料として高い信頼性と高密度実装を可能にするソルダーペースト「D-SOL（ディーソル）」も来場者の関心を集めた。D-SOLは高耐久、高密度、高い生産性など、車載メーカーが求める厳しい条件をクリアした高信頼性のはんだ製品で、車載電子機器の安心実現を代表する製品になる。